

平成25年1月吉日

関係各位

立命館大学

谷 泰弘・村田順二

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は研究室の運営に関して多大なご指導、ご支援を賜り、誠に有難うございます。さて、恒例の研究室卒業研究発表会を下記のように開催させていただきます。ご多忙中恐れ入りますが、ご臨席頂ければ幸いです。なお、お越し頂く場合には資料の準備の都合上、2月27日（水）までに秘書大西（メール：[hov26047@fc.ritsumei.ac.jp](mailto:hov26047@fc.ritsumei.ac.jp) FAX:077-561-3043）までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

日時：平成25年3月5日（火） 13:00～19:00

場所：立命館大学びわこ・くさつキャンパス

防災システムリサーチセンター 2階 第2会議室

（次ページのキャンパスマップをご確認下さい）

スケジュール（案）（変更がある場合もあります）

- 13:00～13:10 ご挨拶（谷）
- 13:10～13:30 多孔質エポキシパッドによる各種工作物の研磨特性（杉浦）
- 13:30～13:50 多孔質エポキシパッドの工作物仕上げ面精度（進藤）
- 13:50～14:10 滞留性を改善したラッピング砥粒の開発（国分）
- 14:10～14:30 ブラシめっき法による電鍍ブレードの作製（賀来）
- 14:30～14:50 ダイシングブレードの補強による切断精度の向上（塩澤）
- 14:50～15:10 三層構造を有する電鍍ブレードの開発（宇野）
- 15:10～15:20 休憩
- 15:20～15:40 ブロンズボンド電鍍ブレードの開発（織田）
- 15:40～16:00 ドラム式電着ダイヤモンドワイヤ製造装置のめっき特性（アイヅト）
- 16:00～16:20 クエン酸ニッケルめっきによる電着工具製造法の検討（山崎）
- 16:20～16:40 ダイヤモンド砥粒の表面処理に関する研究（毒島）
- 16:40～17:00 ろう付けによるダイヤモンドワイヤの開発（市川）
- 17:00～17:20 エッチング援用ダイシングの基礎的検討（三明）
- 17:40～19:30 懇親会（会場：キャンパス内ユニオンスクエア 2階ラポーズ）

以上

## 立命館大学びわこ・くさつキャンパス (BKC) キャンパスマップ

